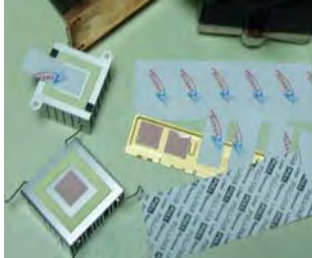


TIC™800P系列 是一種高性能低熔點導熱界面材料。在溫度50°C，TIC™800P開始軟化並流動，填充散熱片和積體電路板的接觸介面上細微不規則間隙，以達到減小熱阻的目的。TIC™800P系列在室溫下呈可彎曲固態，無需增強材料而獨立使用，免除了增強材料對熱傳導性能的影響。

TIC™800P系列 在溫度130°C下持續1000小時，或經歷-25°C到125°C的反覆循環測試，其導熱性能仍不會減退。在工作溫度下，其中相變材料軟化的同時又不會完全液化或溢出。



適用於:

- › 高頻率微處理器
- › 筆記本和桌上型電腦
- › 電腦伺服器
- › 記憶體模組
- › 快取記憶體晶片
- › IGBTs

最小熱阻系列:

- › **0.021°C-in²/W** 熱阻
- › 室溫下具有天然黏性, 無需黏合劑
- › 散熱器無需預熱

TIC™800P 系列特性表

產品名稱	TIC™803P	TIC™805P	TIC™808P	TIC™810P	測試標準
顏色	粉紅	粉紅	粉紅	粉紅	目視
厚度	0.003" (0.076mm)	0.005" (0.126mm)	0.008" (0.203mm)	0.010" (0.254mm)	*****
厚度公差	±0.0006" (±0.016mm)	±0.0008" (±0.019mm)	±0.0008" (±0.019mm)	±0.0012" (±0.030mm)	*****
密度	2.2g/cc				氮氣比重瓶
工作溫度	-25°C~125°C				*****
相變溫度	58°C				*****
定型溫度	70°C for 5 minutes				*****
熱傳導率	0.95 W/mK				ASTM D5470 (修正)
熱阻抗 @ 50 psi(345 KPa)	0.021°C-in²/W	0.024°C-in²/W	0.053°C-in²/W	0.080°C-in²/W	ASTM D5470 (修正)
	0.14°C-cm²/W	0.15°C-cm²/W	0.34°C-cm²/W	0.52°C-cm²/W	

標準厚度:

0.003"(0.076mm) 0.005"(0.127mm) 0.008"(0.203mm) 0.010"(0.254mm)

如需不同厚度請與本公司聯繫。

標準尺寸:

10" x 16"(254mm x 406mm) 16" X 400' (406mm X 121.92M)

TIC™800 系列片料供應時附有白色離型紙及底襯墊，模切半斷加工可提供拉手,也可提供模切成單個形狀型試提供。

壓敏黏合劑:

壓敏黏合劑不適用於TIC800™ 系列產品。

補強材料:

無需補強材料。